

LM4051-N 精密低功耗并联电压基准

1 特性

- 无需输出电容器
- 能够接受电容负载
- 1.225V 的反向击穿电压选项和可调节电压选项
- 主要规格：
 - 输出电压容差 (A 级、25°C) $\pm 0.1\%$ (最大值)
 - 输出噪声 (10Hz 至 10kHz) 20 μ Vrms
 - 工作电流范围：60 μ A 至 12mA
 - 工业温度范围：-40°C 至 85°C
 - 扩展温度范围：-40°C 至 125°C
 - 温度系数：50ppm/°C (最大值)

2 应用

- 电池供电设备
- 数据采集系统
- 仪表和测试设备
- 过程控制
- 能源管理/计量
- 汽车电子产品
- 精密音频
- 基站
- 电池充电器
- 医疗设备
- 通信

3 说明

LM4051-N 精密电压基准专为空间受限的应用而设计，采用超小型 (3mm x 1.30mm) SOT-23 表面贴装封装。LM4051-N 采用的先进设计无需使用外部稳定电容器，同时可确保在任何容性负荷下的稳定性，这使得 LM4051-N 非常易于使用。它还提供了固定电压 (1.225V) 和可调节反向击穿电压，进一步减少设计工作量。LM4051-1.2 和 LM4051-ADJ 的最小工作电流为 60 μ A。两个版本的最大工作电流均为 12mA。

LM4051-N 具备三个等级 (A、B 和 C)。等级最好的器件 (A) 的初始精度为 0.1%，而 B 级器件的初始精度为 0.2%，C 级器件的初始精度为 0.5%，所有这些器件的温度系数均为 50 ppm/°C，专为 -40°C 至 125°C 而设计。

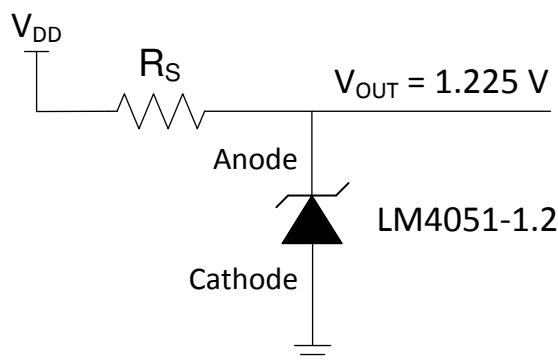
LM4051-N 在晶圆筛选期间使用了保险丝和基准电压齐纳击穿修整，确保主要器件在 25°C 时的精度优于 $\pm 0.1\%$ (A 级)。

器件信息

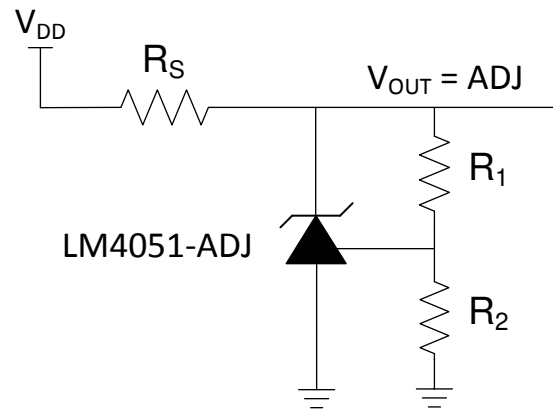
器件型号	封装 ⁽¹⁾	本体尺寸 (标称值) ⁽²⁾
LM4051-N	SOT-23 (3)	3.00mm x 1.30mm

(1) 如需了解所有可用封装，请参阅数据表末尾的可订购产品附录。

(2) 封装尺寸 (长 × 宽) 为标称值，并包括引脚 (如适用)。



1.2 V_{REF} 简化版原理图



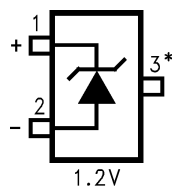
可调基准简化版原理图



内容

1 特性	1	7.3 特性说明	12
2 应用	1	7.4 器件功能模式	12
3 说明	1	8 应用和实施	13
4 引脚配置和功能	3	8.1 应用信息	13
引脚功能.....	3	8.2 典型应用	14
5 规格	4	8.3 系统示例	16
5.1 绝对最大额定值.....	4	8.4 电源相关建议	19
5.2 ESD 等级.....	4	8.5 布局	20
5.3 建议运行条件.....	4	9 器件和文档支持	21
5.4 热性能信息.....	5	9.1 接收文档更新通知.....	21
5.5 LM4051-1.2 电气特性.....	5	9.2 支持资源.....	21
5.6 LM4051-ADJ 电气特性.....	6	9.3 商标.....	21
5.7 典型特性.....	8	9.4 静电放电警告.....	21
6 参数测量信息	11	9.5 术语表.....	21
7 详细说明	12	10 修订历史记录	21
7.1 概述.....	12	11 机械、封装和可订购信息	21
7.2 功能方框图.....	12		

4 引脚配置和功能



* 该引脚可以悬空或连接到引脚 2。(1)

图 4-1. DBZ 封装 1.2V、3 引脚 SOT-23 顶视图

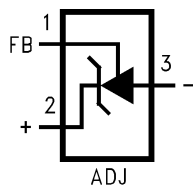


图 4-2. 可调节的 DBZ 封装，3 引脚 SOT-23 顶视图

引脚功能

名称	引脚		I/O	说明
	1.2V	ADJ		
正极	2	3	O	通用引脚，通常接地
负极	1	2	I/O	并联电流/电压输入
NC	3	-	-	必须悬空或连接到阳极 (1)。
FB	-	1	I	相对阴极的阈值

(1) 在具有高电磁干扰（例如放置在变压器或其他电磁源附近时）或显著高频开关噪声的应用中，TI 建议将该引脚连接到阳极

5 规格

5.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）⁽¹⁾

	最小值	最大值	单位
反向电流		20	mA
正向电流		10	mA
最大输出电压 (LM4051-ADJ)		15	V
功率耗散 ($T_A = 25^{\circ}\text{C}$) ⁽²⁾ M3 封装		280	mW
引线式温度 M3 封装	气相 (60 秒)	215	$^{\circ}\text{C}$
	红外 (15s)	220	
贮存温度, T_{stg}	-65	150	$^{\circ}\text{C}$

- (1) 应力超出绝对最大额定值下列出的值可能会对器件造成永久损坏。这些列出的值仅仅是应力等级，这并不表示器件在这些条件下以及在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
- (2) 最大功率耗散必须在高温下降额，并由 T_{Jmax} （最高结温）、 θ_{JA} （结至环境热阻）和 T_A （环境温度）决定。在任何温度下，允许的最大功率耗散为 $P_{\text{Dmax}} = (T_{\text{Jmax}} - T_A) / \theta_{\text{JA}}$ 或者 节 5.1 中给出的数值，以较低者为准。在 LM4051-N 中， $T_{\text{Jmax}} = 125^{\circ}\text{C}$ ，在电路板上安装时的典型热阻 (θ_{JA}) 为 280°C/W （采用 SOT-23 封装）。

5.2 ESD 等级

		值	单位
$V_{\text{(ESD)}}$ 静电放电	人体放电模型 (HBM)，符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准 ^{(1) (2)}	± 2000	V
	充电器件模型 (CDM)，符合 JEDEC 规范 JESD22-C101 ⁽³⁾	± 500	

- (1) JEDEC 文档 JEP155 指出：500V HBM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。
- (2) 人体放电模式是一个通过 $1.5\text{k}\Omega$ 电阻器对每个引脚放电的 100pF 电容器。在人体放电模式中，所有引脚的额定值均为 2kV ，而反馈引脚的额定值为 1kV 。
- (3) JEDEC 文档 JEP157 指出：250V CDM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。若部署必要的预防措施，不足 250V CDM 时也能进行生产。

5.3 建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）

		最小值	标称值	最大值	单位
温度 ($T_{\text{min}} \leq T_A \leq T_{\text{max}}$)	工业温度	-40		85	$^{\circ}\text{C}$
	工作温度	-40		125	
反向电流	LM4051-1.2	0.06		12	mA
	LM4051-ADJ	0.06		12	
输出电压	LM4051-ADJ	1.24		10	V

5.4 热性能信息

热指标 ⁽¹⁾		LM4051-ADJ , LM4051-1.2 V	单位
		DBZ	
		3 引脚	
$R_{\theta JA}$	结至环境热阻	214.7	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	结至外壳 (顶部) 热阻	76.4	°C/W
$R_{\theta JB}$	结至电路板热阻	41.3	°C/W
ψ_{JT}	结至顶部特征参数	2.0	°C/W
ψ_{JB}	结至电路板特征参数	40.9	°C/W

(1) 有关新旧热指标的更多信息，请参阅 [半导体和 IC 封装热指标](#) 应用报告。

5.5 LM4051-1.2 电气特性

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明)

参数		测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
V_R	反向击穿电压	$I_R = 100 \mu A$		1.225			V
	反向击穿电压容差 ⁽²⁾	$I_R = 100 \mu A$	LM4051AIM3 ⁽¹⁾			±1.2	mV
			LM4051BIM3 LM4051BEM3 ⁽¹⁾			±2.4	
			LM4051CIM3 ⁽¹⁾			±6	
		工业温度范围 $T_A = T_J = T_{MIN}$ 至 T_{MAX}	LM4051AIM3 ⁽¹⁾			±5.2 ⁽²⁾	
			LM4051BIM3 ⁽¹⁾			±6.4 ⁽²⁾	
			LM4051CIM3 ⁽¹⁾			±10.1 ⁽²⁾	
I_{RMIN}	最小工作电流	扩展温度：范围 $T_A = T_J = T_{MIN}$ 至 T_{MAX}				±8.6 ⁽²⁾	μA
		$T_J = 25^\circ C$				39	
		工业温度范围 $T_A = T_J = T_{MIN}$ 至 T_{MAX}				65	
$\Delta V_R / \Delta T$	平均反向击穿电压温度系数 ⁽²⁾	扩展温度：范围 $T_A = T_J = T_{MIN}$ 至 T_{MAX}				70	ppm/°C
		$I_R = 10mA$				±20	
		$I_R = 1mA$				±15	
		$I_R = 100 \mu A$ $\Delta T = -40^\circ C$ 至 $125^\circ C$	$T_J = 25^\circ C$ $T_A = T_J = T_{MIN}$ 至 T_{MAX}			±15 ±50 ⁽²⁾	
$\Delta V_R / I_R$	随着工作电流的变化， 反向击穿电压会发生变化	$I_{RMIN} \leq I_R \leq 1mA$	$T_J = 25^\circ C$			0.3	mV
			工业温度范围 $T_A = T_J = T_{MIN}$ 至 T_{MAX}			1.1 ⁽²⁾	
			扩展温度：范围 $T_A = T_J = T_{MIN}$ 至 T_{MAX}			1.5 ⁽²⁾	
		$1mA \leq I_R \leq 12mA$	$T_J = 25^\circ C$			1.8	
			工业温度范围 $T_A = T_J = T_{MIN}$ 至 T_{MAX}			6 ⁽²⁾	
			扩展温度：范围 $T_A = T_J = T_{MIN}$ 至 T_{MAX}			8 ⁽²⁾	
Z_R	反向动态阻抗	$I_R = 1mA$, $f = 120Hz$				0.5	Ω
e_N	宽带噪声	$I_R = 100 \mu A$ $10Hz \leq f \leq 10kHz$				20	μ Vrms

5.5 LM4051-1.2 电气特性 (续)

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明)

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
ΔV_R 反向击穿电压的长期稳定性 ⁽³⁾	$t = 1000\text{hrs}$, $T = 25^\circ\text{C} \pm 0.1^\circ\text{C}$, $I_R = 100\ \mu\text{A}$		120		ppm
V_{HYST} 热磁滞 ⁽⁴⁾	$\Delta T = -40^\circ\text{C}$ 至 125°C		0.36		mV/V

- (1) 限值在 25°C 下经过完整的生产测试。温度范围内的限值使用统计质量控制 (SQC) 方法进行验证。这些限值用于计算 National 的 AOQL。
- (2) 反向击穿电压容差的过温限值被定义为室温反向击穿电压容差 $\pm[(\Delta V_R/\Delta T)(\max \Delta T)(V_R)]$ 。其中, $\Delta V_R/\Delta T$ 是 V_R 温度系数, $\max \Delta T$ 是从 25°C 的参考点到 T_{MAX} 或 T_{MIN} 的最大温差, V_R 是反向击穿电压。 $\max \Delta T = 65^\circ\text{C}$ 的工业温度范围内不同等级的总过温容差如下所示:
- A 级: $\pm 0.425\% = \pm 0.1\% \pm 50\text{ ppm}/^\circ\text{C} \times 65^\circ\text{C}$
 - B 级: $\pm 0.525\% = \pm 0.2\% \pm 50\text{ ppm}/^\circ\text{C} \times 65^\circ\text{C}$
 - C 级: $\pm 0.825\% = \pm 0.5\% \pm 50\text{ ppm}/^\circ\text{C} \times 65^\circ\text{C}$

因此, 举例来讲, A 级 LM4051-1.2 的过温反向击穿电压容差为 $\pm 1.2\text{V} \times 0.425\% = \pm 5.2\text{mV}$ 。

- (3) 长期稳定性是在 1000 小时内测得的 25°C 时的 V_R 。
- (4) 热磁滞定义为循环至温度 -40°C 后在 $+25^\circ\text{C}$ 时测得的电压与循环至温度 $+125^\circ\text{C}$ 后在 25°C 时测得的电压之间的差异。

5.6 LM4051-ADJ 电气特性

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明)

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
基准电压	$I_R = 100\ \mu\text{A}$, $V_{\text{OUT}} = 5\text{V}$		1.212		V
V_{REF} 基准电压容差 ^{(2) (4)}	$I_R = 100\ \mu\text{A}$, $V_{\text{OUT}} = 5\text{V}$	LM4051AIM3 ⁽¹⁾		± 1.2	mV
		LM4051BIM3 ⁽¹⁾		± 2.4	
		LM4051CIM3 ⁽¹⁾		± 6	
	工业温度范围 $T_A = T_J = T_{\text{MIN}}$ 至 T_{MAX}	LM4051AIM3 ⁽¹⁾		± 5.2	
		LM4051BIM3 ⁽¹⁾		± 6.4	
		LM4051CIM3 ⁽¹⁾		± 10.1	
I_{RMIN} 最小工作电流	LM4051AIM3 ⁽¹⁾		36		μA
	LM4051BIM3 ⁽¹⁾		36		
	LM4051CIM3 ⁽¹⁾		36		
	工业温度范围 $T_A = T_J = T_{\text{MIN}}$ 至 T_{MAX}	LM4051AIM3 ⁽¹⁾		60	
		LM4051BIM3 ⁽¹⁾		60	
		LM4051CIM3 ⁽¹⁾		65	
$\Delta V_{\text{REF}}/\Delta I_R$ 随着工作电流的变化, 基准电压会发生变化	$I_{\text{RMIN}} \leq I_R \leq 1\text{mA}$ $V_{\text{OUT}} \geq 1.6\text{V}$ ⁽³⁾	$T_J = 25^\circ\text{C}$		0.3	mV
		工业温度范围 $T_A = T_J = T_{\text{MIN}}$ 至 T_{MAX}		1.1 ⁽²⁾	
	$1\text{mA} \leq I_R \leq 12\text{mA}$ $V_{\text{OUT}} \geq 1.6\text{V}$ ⁽³⁾	$T_J = 25^\circ\text{C}$		0.6	
		工业温度范围 $T_A = T_J = T_{\text{MIN}}$ 至 T_{MAX}		6 ⁽²⁾	
$\Delta V_{\text{REF}}/\Delta V_O$ 随着输出电压的变化, 基准电压会发生变化	$I_R = 0.1\text{mA}$	$T_J = 25^\circ\text{C}$		-1.69	mV
		工业温度范围 $T_A = T_J = T_{\text{MIN}}$ 至 T_{MAX}		-2.8 ⁽²⁾	
I_{FB} 反馈电流			70	130	nA

5.6 LM4051-ADJ 电气特性 (续)

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明)

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
$\Delta V_{REF}/\Delta T$ 平均基准电压温度系数 (注释 8)	$I_R = 10\text{mA}$	$T_J = 25^\circ\text{C}$	20		ppm/ $^\circ\text{C}$
		工业温度范围 $T_A = T_J = T_{MIN}$ 至 T_{MAX}	$\pm 50^{(2)}$		
	$I_R = 1\text{mA}$	$T_J = 25^\circ\text{C}$	15		
		工业温度范围 $T_A = T_J = T_{MIN}$ 至 T_{MAX}	$\pm 50^{(2)}$		
	$I_R = 100\text{ }\mu\text{A}$	$T_J = 25^\circ\text{C}$	15		
		工业温度范围 $T_A = T_J = T_{MIN}$ 至 T_{MAX}	$\pm 50^{(2)}$		
Z_{OUT} 动态输出阻抗	$I_R = 1\text{mA}$, $f = 120\text{Hz}$, $I_{AC} = 0.1 I_R$	$V_{OUT} = V_{REF}$	0.3		Ω
		$V_{OUT} = 10\text{V}$	2		
e_N 宽带噪声	$I_R = 100\text{ }\mu\text{A}$, $V_{OUT} = V_{REF}$, $10\text{Hz} \leq f \leq 10\text{kHz}$		20		μVrms
ΔV_{REF} 基准电压长期稳定性 ⁽⁵⁾	$t = 1000\text{hrs}$, $I_R = 100\text{ }\mu\text{A}$, $T = 25^\circ\text{C} \pm 0.1^\circ\text{C}$		120		ppm
V_{HYST} 热磁滞 ⁽⁶⁾	$\Delta T = -40^\circ\text{C}$ 至 $+125^\circ\text{C}$		0.3		mV/V

- 限值在 25°C 下经过完整的生产测试。温度范围内的限值使用统计质量控制 (SQC) 方法进行验证。这些限值用于计算 National 的 AOQL。
- 反向击穿电压容差的过温限值被定义为室温反向击穿电压容差 $\pm [(\Delta V_R/\Delta T)(\max \Delta T)(V_R)]$ 。其中, $\Delta V_R/\Delta T$ 是 V_R 温度系数, $\max \Delta T$ 是从 25°C 的参考点到 T_{MAX} 或 T_{MIN} 的最大温差, 且 V_R 是反向击穿电压。 $\max \Delta T = 65^\circ\text{C}$ 的工业温度范围内不同等级的总过温容差如下所示:
 - A 级: $\pm 0.425\% = \pm 0.1\% \pm 50\text{ppm}/^\circ\text{C} \times 65^\circ\text{C}$
 - B 级: $0.525\% = \pm 0.2\% \pm 50\text{ppm}/^\circ\text{C} \times 65^\circ\text{C}$
 - C 级: $0.825\% = \pm 0.5\% \pm 50\text{ppm}/^\circ\text{C} \times 65^\circ\text{C}$
因此, 举例来讲, A 级 LM4051-1.2 的过温反向击穿电压容差为 $\pm 1.2\text{V} \times 0.425\% = \pm 5.2\text{mV}$ 。
- 在 $V_{OUT} \leq 1.6\text{V}$ 时, 采用 SOT-23 封装的 LM4051-ADJ 必须以较低的 I_R 运行。这是由裸片 (-) 输出和封装 (-) 输出引脚之间的裸片连接串联电阻引起的。请参阅 节 5.7 部分中的输出饱和度和曲线。
- 基准电压和温度系数随输出电压变化而变化。请参阅 节 5.7 曲线。
- 长期稳定性是在 1000 小时内测得的 25°C 时的 V_R 。
- 热磁滞定义为循环至温度 -40°C 后在 25°C 时测得的电压与循环至温度 125°C 后在 25°C 时测得的电压之间的差异。

5.7 典型特性

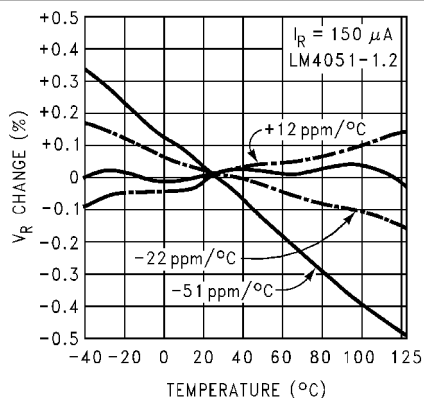


图 5-1. 不同平均温度系数的温度漂移

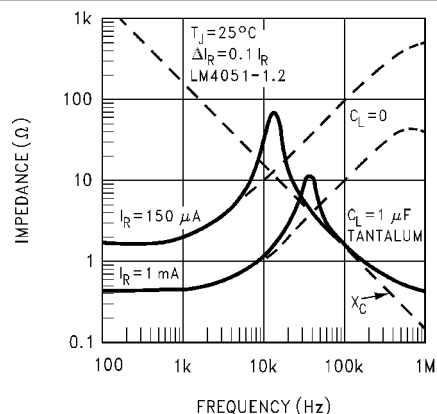


图 5-2. 输出阻抗与频率间的关系

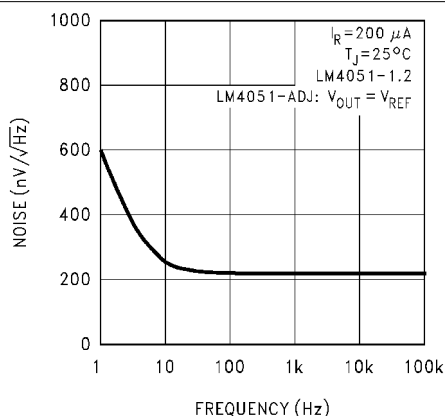


图 5-3. 噪声电压

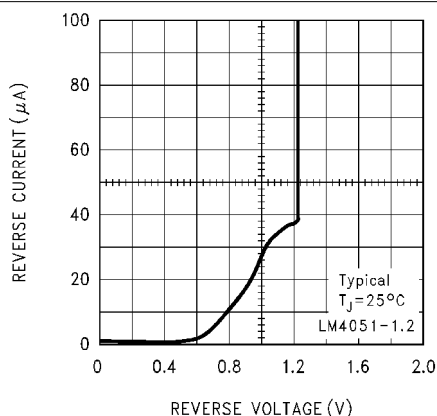


图 5-4. 反向特性和最小工作电流

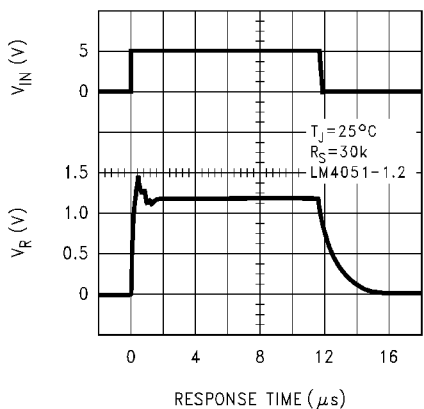


图 5-5. 启动特性

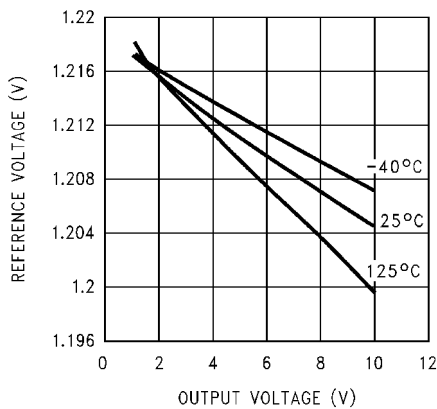


图 5-6. 基准电压与输出电压和温度间的关系

5.7 典型特性 (续)

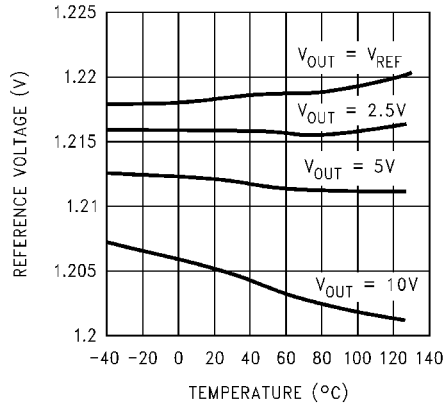


图 5-7. 基准电压与温度和输出电压间的关系

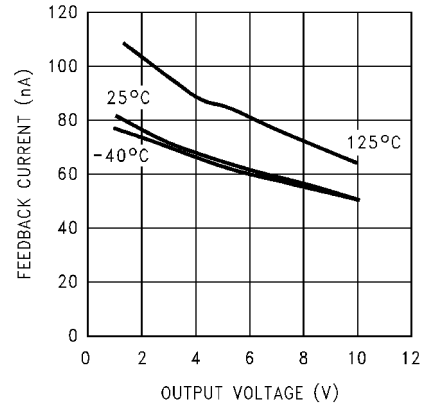


图 5-8. 反馈电流与输出电压和温度间的关系

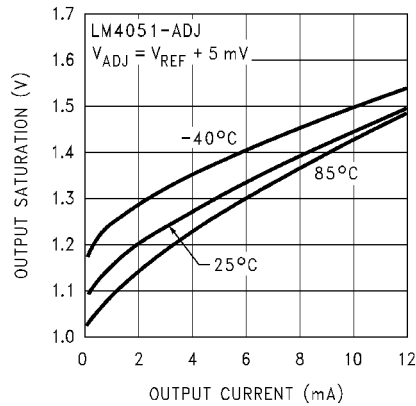


图 5-9. 输出电流 (仅限 SOT-23)

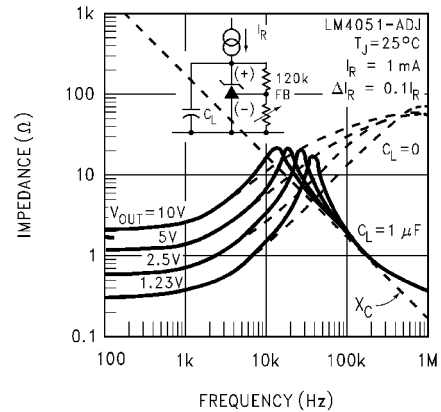


图 5-10. 输出阻抗与频率间的关系

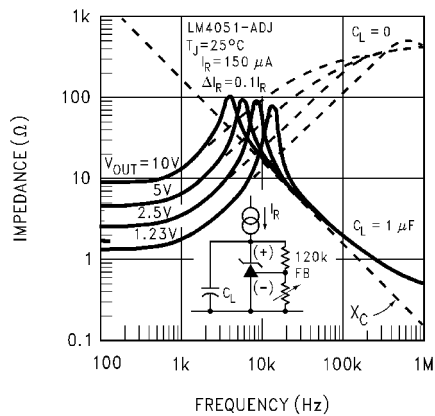


图 5-11. 输出阻抗与频率间的关系

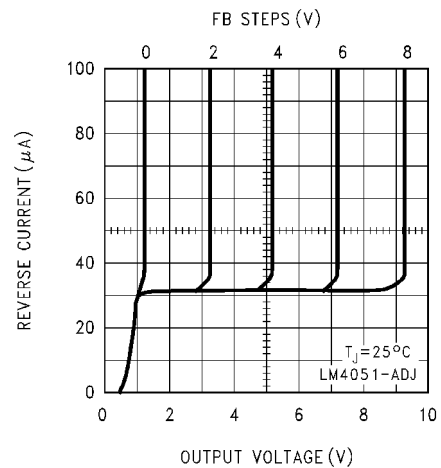


图 5-12. 反向特性

5.7 典型特性 (续)

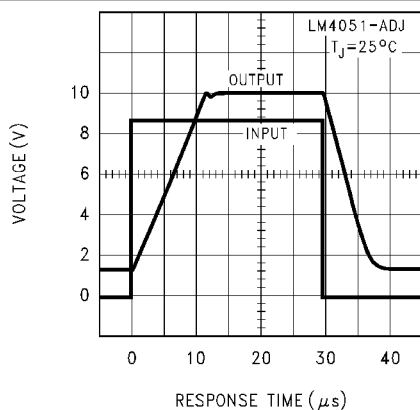


图 5-13. 大信号响应

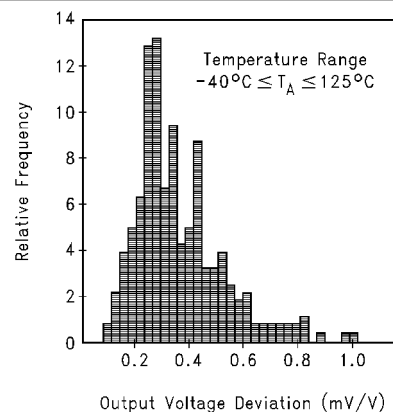


图 5-14. 热迟滞

6 参数测量信息

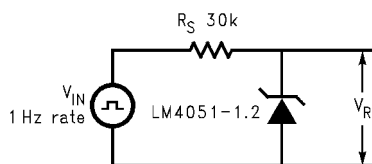


图 6-1. 启动特性测试电路

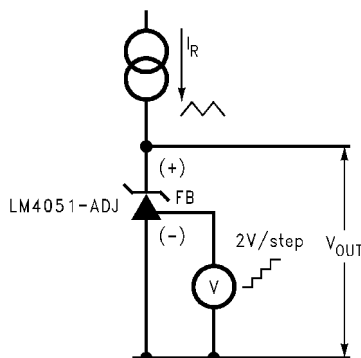


图 6-2. 反向特性测试电路

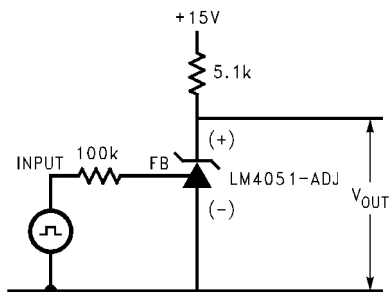


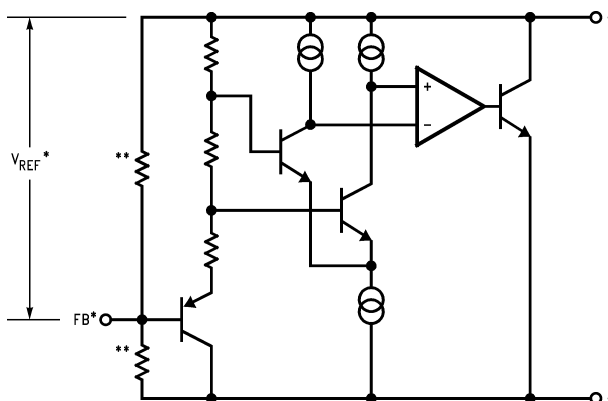
图 6-3. 大信号响应测试电路

7 详细说明

7.1 概述

LM4051-N 是采用 SOT-23 表面贴装封装的精密电压基准。LM4051-N 提供 1.225V 固定电压选项和可调节电压选项。LM4051-N 具有三种不同的容差等级 (A、B 和 C)。等级最好的器件 (A) 的初始精度为 0.1%，B 级器件的精度为 0.2%，C 级器件的精度为 0.5%，所有这些器件的温度系数均在 -40°C 至 125°C 范围内保持为 50ppm/ $^{\circ}\text{C}$ 。

7.2 功能方框图



*仅限 LM4051-ADJ

**仅限 LM4051-1.2

7.3 特性说明

LM4051-N 器件实际上是一个精密齐纳二极管。该器件需要较小的静态电流即可进行调节，并通过将更多或更少的电流分流到接地端来调节输出电压，具体取决于输入电压和负载。外部元件唯一的要求是在阴极和输入电压之间连接一个电阻器来设置输入电流。可以在输入或输出端使用外部电容器，但这并不是必需的。

在可调节版本中，当从阴极引脚和基准引脚施加反馈时，LM4051-N 将作为齐纳二极管，根据向阴极提供的电流，调节至恒定电压。这是由于内部放大器和基准进入了适当的运行区域。在开环、伺服或误差放大实现中，为了使该器件保持在合适的线性区域，必须向该器件施加与在上述反馈情况下所需电流的大小相同的电流，从而使 LM4051-N 具有足够的增益。

7.4 器件功能模式

7.4.1 LM4051-N-1.2V

LM4051-N-1.2V 器件是一款固定输出电压器件，其反馈为内部反馈。因此，该器件只能在闭环模式下运行，无法调节输出电压。只要 I_R 介于 I_{RMIN} 之间，输出电压就会保持在稳压范围内。只要为输入电压范围和负载电流范围选择合适的外部电阻器，就能确保满足这些条件。

7.4.2 LM4051-N - ADJ

涉及 LM4051-N 的多数应用都是采用闭环工作模式，从而实现调节至固定电压或电流的目的。反馈使得该器件能够作为误差放大器，计算输出电压的一部分，并对其进行调整以保持所期望的调节。实现该目标的途径是：将输出电压以某种方式关联至基准引脚，从而使其等于内部基准电压，这可以通过电阻反馈或直接反馈来实现。

8 应用和实例

备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 器件规格的范围，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户应负责确定器件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计，以确保系统功能。

8.1 应用信息

LM4051-N 是一款经过曲率校正的精密微功耗带隙并联电压基准。在空间受限的应用中，LM4051-N 采用超小型 SOT-23 表面贴装封装。LM4051-N 设计为在“+”引脚和“-”引脚之间无需连接外部电容器的情况下稳定运行。不过，如果使用了旁路电容器，LM4051-N 仍可以保持稳定。通过选择 1.2V 固定电压或可调反向击穿电压，可以进一步减少设计工作量。LM4051-1.2 和 LM4051-ADJ 的最小工作电流为 60 μ A。两个版本的最大工作电流均为 12mA。

采用 SOT-23 封装的 LM4051-N 通过封装的裸片连接接口，将引脚 3 连接为 (-) 输出。因此，LM4051-1.2 的引脚 3 必须保持悬空或连接到引脚 2，LM4051-ADJ 的引脚 3 是 (-) 输出。

典型热磁滞规格定义为热循环后测量的 +25°C 电压变化。该器件热循环至 -40°C，然后在 25°C 下进行测量。接下来，将器件热循环至 +125°C，再次在 25°C 下进行测量。几次在 25°C 下进行测量后获得的 $V_{OUT} \Delta$ 移位是热磁滞。热磁滞在精密基准中很常见，其是由热机械封装应力引起的。环境贮存温度、工作温度和电路板安装温度的变化都是导致热磁滞的因素。

在传统的并联稳压器应用中 (图 8-1)，电源电压和 LM4051-N 之间连接了一个外部串联电阻器 (R_S)。 R_S 决定流经负载 (I_L) 和 LM4051-N (I_Q) 的电流。由于负载电流和电源电压可能会发生变化，因此 R_S 需要足够小，至少能为 LM4051-N 提供最小可接受 I_Q ，即使电源电压处于最小值且负载电流处于最大值时也是如此。当电源电压处于最大值且 I_L 处于最小值时， R_S 需要足够大，使流经 LM4051-N 的电流小于 12mA。

R_S 是根据电源电压 (V_S)、所需负载和工作电流 (I_L 和 I_Q) 以及 LM4051-N 的反向击穿电压 V_R 来选择的。

$$R_S = \frac{V_S - V_R}{I_L + I_Q} \quad (1)$$

LM4051-ADJ 的输出电压可以调节为 1.24V 至 10V 范围内的任何值。输出电压是内部基准电压 (V_{REF}) 和外部反馈电阻比的函数，如 图 8-3 所示。可使用 方程式 2 查看输出电压：

$$V_O = V_{REF} \left[\left(R_2 / R_1 \right) + 1 \right] \quad (2)$$

其中

- V_O 为输出电压

$$R_S = \frac{V_S - V_R}{I_L + I_Q + I_F} \quad (3)$$

内部 V_{REF} 的实际值是 V_O 的函数。校正后的 V_{REF} 由 方程式 4 确定：

$$V_{REF} = V_O (\Delta V_{REF} / \Delta V_O) + V_Y \quad (4)$$

其中

- $V_Y = 1.22V$

$\Delta V_{REF}/\Delta V_O$ 可在 [节 5.6](#) 中查询，通常为 $-1.55mV/V$ 。您可以通过将 [方程式 2](#) 中的 V_{REF} 值替换为使用 [方程式 4](#) 查询到的值，以此获得更准确的输出电压指示。

8.2 典型应用

8.2.1 并联稳压器

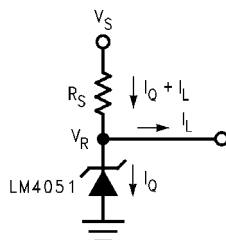


图 8-1. 并联稳压器

8.2.1.1 设计要求

$$V_{IN} > V_{OUT}$$

选择 R_S ，以便：

$$I_{RMIN} < I_R < I_{RMAX}, \text{ 其中 } I_{RMAX} = 12mA$$

有关每个电压选项和等级的最小工作电流，请参阅 [节 5.5](#)。

8.2.1.2 详细设计过程

必须选择电阻器 R_S ，确保在整个 V_{IN} 范围和负载电流范围内，电流 I_R 保持在器件的工作区域内。需要考虑的两个极值是最大值时的 V_{IN} 和最小值时的负载，其中 R_S 必须足够大，使 $I_R < I_{Rmax}$ 。在大多数设计中， $0.1mA \leq I_R \leq 1mA$ 是一个很好的起点。

使用交叉与交叉方式将 R_S 设置在 R_{S_MIN} 和 R_{S_MAX} 之间。

$$R_{S_MIN} = \frac{V_{IN_MAX} - V_{OUT}}{I_{LOAD_MIN} + I_{R_MAX}} \quad (5)$$

$$R_{S_MAX} = \frac{V_{IN_MIN} - V_{OUT}}{I_{LOAD_MAX} + I_{R_MIN}} \quad (6)$$

8.2.1.3 应用曲线

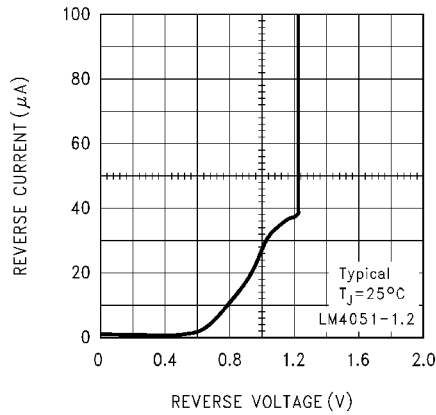


图 8-2. 反向特性和最小工作电流

8.2.2 可调节并联稳压器

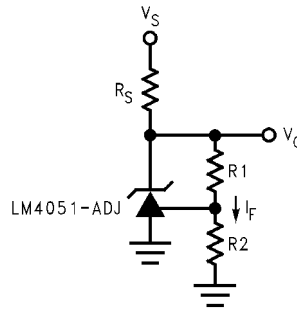


图 8-3. 可调节并联稳压器

8.2.2.1 设计要求

$$V_{IN} > V_{OUT}$$

选择 R_S ，以便：

$$I_{RMIN} < I_R < I_{RMAX}, \text{ 其中 } I_{RMAX} = 12\text{mA}$$

有关每个电压选项和等级的最小工作电流，请参阅 节 5.6。

8.2.2.2 详细设计过程

为了将阴极电压编程至调节电压，必须对阴极和阳极引脚之间的电阻桥进行分流，即将中点处连接至基准引脚。您可以在图 8-3 中看到该电路，其中电阻桥由 R_1 和 R_2 组成。您可以使用方程式 7 中所示的公式计算出并联稳压器配置中的阴极/输出电压近似值。您还可以先考虑方程式 8 等式中所示的阴极电流，再更精确地确定阴极电压。

$$V_O = V_{REF}[(R_2/R_1) + 1] \quad (7)$$

$$V_O = (1 + R_2/R_1) \times (V_{REF} - I_{REF} \times R_1) \quad (8)$$

为了使该公式有效，LM4051-ADJ 必须完全偏置，以便具有足够的开环增益来减小任何增益误差。这可以通过满足 节 5.6 中指示的 I_{RMIN} 规格来实现。当可调版本 LM4051-N 的输出电压 V_Z 设置为低于 2.5V 时，与设置为等于或高于 2.5V 的输出电压相比，该器件已升高的基准电压随着输出电压的变化 ($\Delta V_{REF}/\Delta V_O$) 而变化

8.3 系统示例

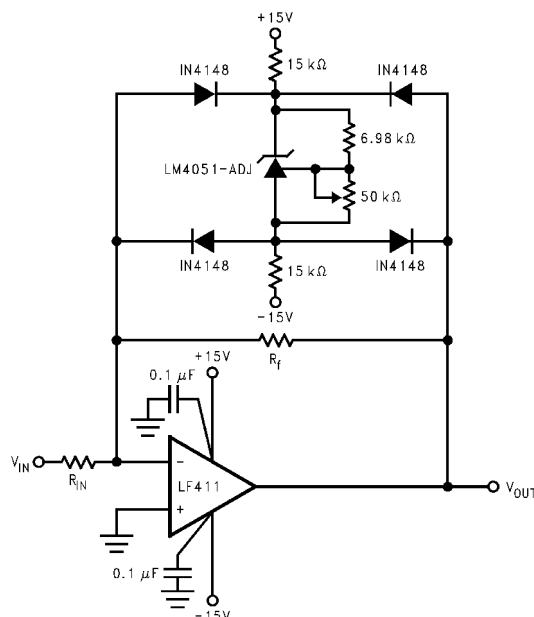


图 8-4. 有界放大器可减少饱和引起的延迟，并可防止后续级损坏。标称钳位电压为 $\pm V_O$ (LM4051-N 的反向击穿电压) +2 二极管 V_F 。

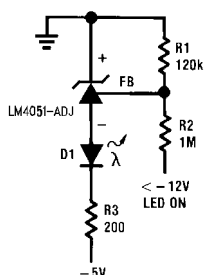


图 8-5. 电压电平检测器

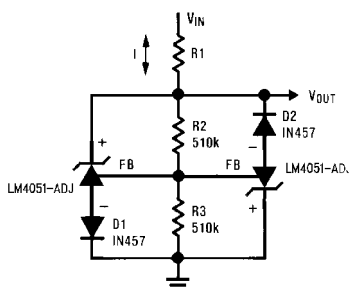


图 8-6. 电压电平检测器

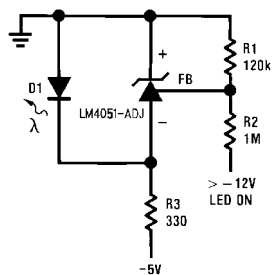


图 8-7. 快速正钳位 $2.4V + V_{D1}$

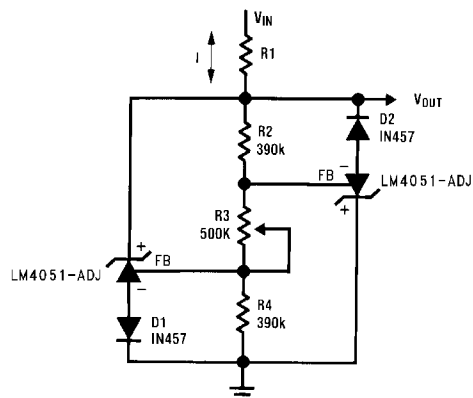


图 8-8. 双向钳位 $\pm 2.4V$

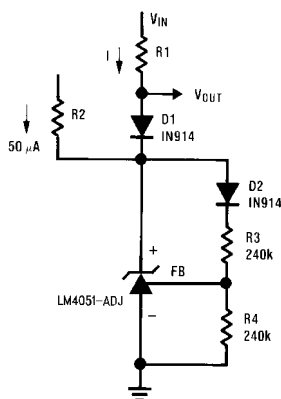


图 8-9. 双向可调节钳位 $\pm 18V$ 到 $\pm 2.4V$

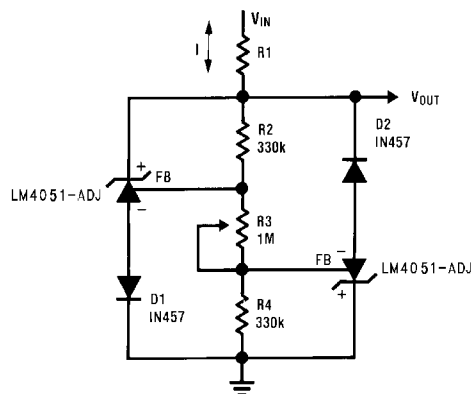
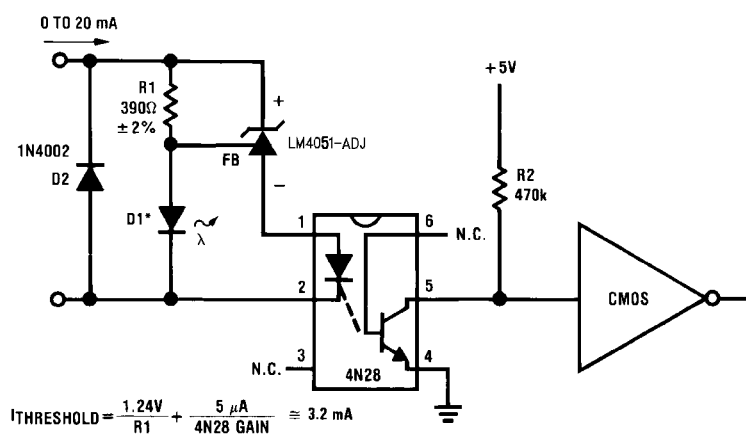
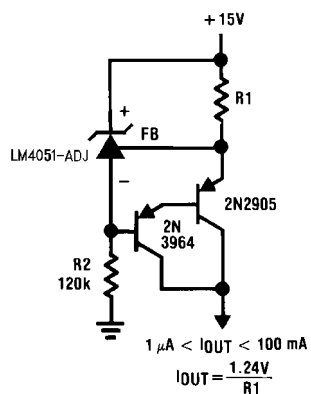
图 8-10. 双向可调节钳位 $\pm 2.4\text{V}$ 到 $\pm 6\text{V}$ 

图 8-11. 简单的浮动电流检测器



* D1 可以是任意 LED，在 3mA 时 $V_F = 1.5\text{V}$ 至 2.2V 。D1 可用作指示灯。如果 $I_{\text{THRESHOLD}}$ 下降到低于阈值电流，则 D1 将导通， $I = 0$ 除外。

图 8-12. 电流源

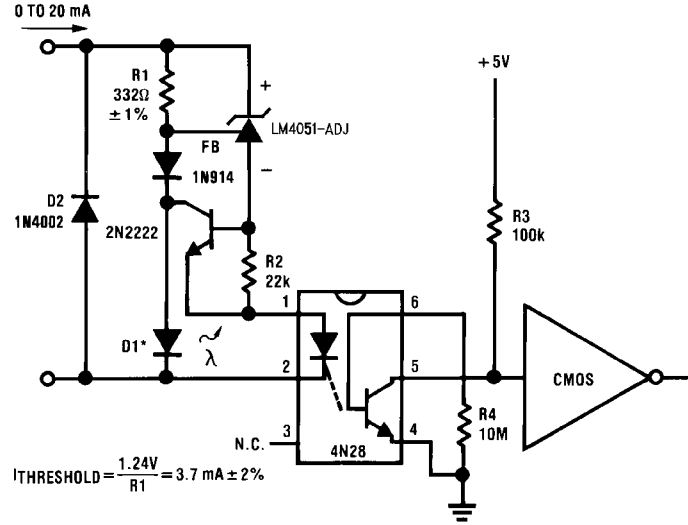


图 8-13. 精密浮动电流检测器

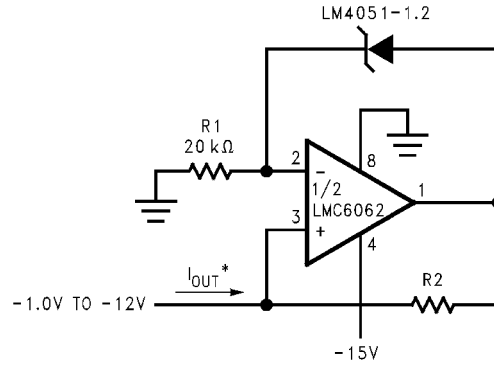


图 8-14. 1 μA 至 1mA 的精密电流源

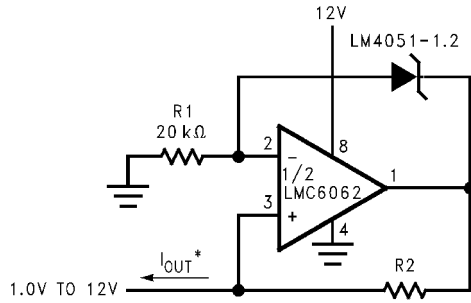


图 8-15. 1 μA 至 1mA 的精密电流源

8.4 电源相关建议

尽管输入电压线路上不需要旁路电容器，TI 建议降低可能影响输出的输入噪声。建议使用 0.1μF 陶瓷电容器或更大的电容器。

为了避免不超出最大阴极电流，请确保电源电流受到限制。对于分流高电流的应用，请注意阴极和阳极迹线的长度，从而调整迹线宽度以获得适当的电流密度。

8.5 布局

8.5.1 布局指南

将旁路电容器尽可能靠近器件放置。载流迹线需要具有适合电流量的宽度。将 R_S 放置在尽可能靠近阴极的位置。尽管这并不重要，但应尽可能使反馈电阻器靠近器件。

8.5.2 布局示例

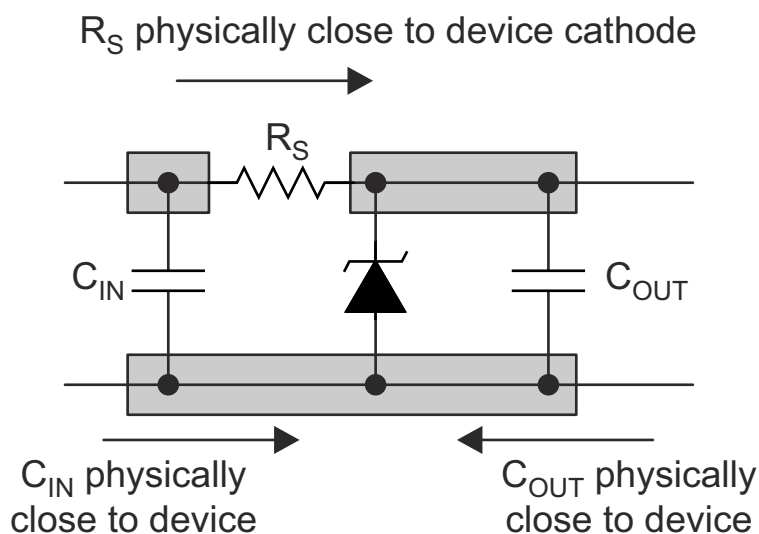


图 8-16. 布局图

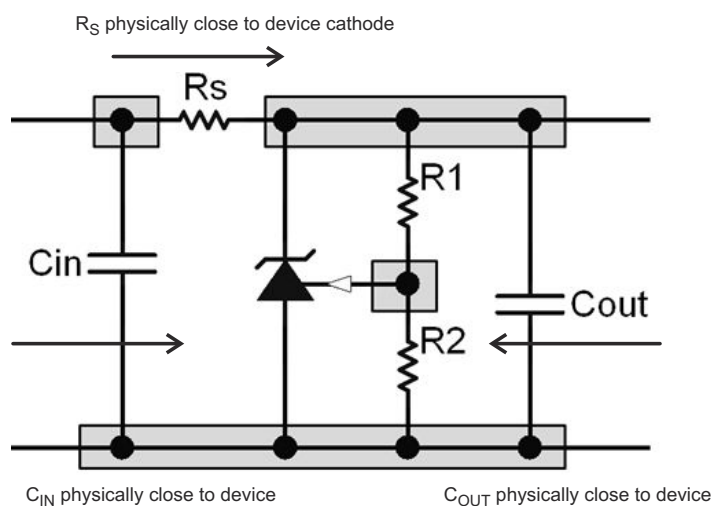


图 8-17. 反馈电阻器布局图

9 器件和文档支持

9.1 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 ti.com 上的器件产品文件夹。点击右上角的 [提醒我](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

9.2 支持资源

[TI E2E™ 中文支持论坛](#) 是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的 [使用条款](#)。

9.3 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

9.4 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

9.5 术语表

[TI 术语表](#) 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

10 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision D (September 2018) to Revision E (June 2024)	Page
• 更新了 <i>应用</i> 链接.....	1
• 添加了有关高 EMI 环境中器件行为的信息。.....	3
• 添加了有关高 EMI 环境中器件行为的信息。.....	3
• 删除了机器模型 (MM) ESD 规格且添加了 CDM ESD 规格。.....	4
• 更正了公式 7 和公式 8，添加了输出电压低于 2.5V 时的器件行为信息.....	15
• 针对包含“X”的器件型号，添加了器件型号澄清说明。.....	21

Changes from Revision C (March 2005) to Revision D (September 2018)	Page
• 添加了 <i>器件信息表</i> 、 <i>器件比较表</i> 、 <i>ESD 等级表</i> 、 <i>特性说明部分</i> 、 <i>器件功能模式</i> 、 <i>应用和实施方式</i> 、 <i>电源相关建议部分</i> 、 <i>布局部分</i> 、 <i>器件和文档支持部分</i> 以及 <i>机械、封装和可订购信息部分</i>	1

11 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。包含“X”的器件型号与不包含“X”的器件型号具有相同的电气特性。

表 11-1. SOT-23 封装标记信息

器件标识	字段定义		
RHA RIA	第一个字段： R = 基准	第二个字段： H = 1.225V 电压选项 I = 可调节	第三个字段： A-C = 初始反向击穿 电压或基准电压容差 A = $\pm 0.1\%$ 、B = $\pm 0.2\%$ 、C = $\pm 0.5\%$
RHB RIB			
RHC RIC			

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
LM4051AIM3-1.2/NO.A	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 SMALL T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	RHA
LM4051AIM3-1.2/NOPB	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 SMALL T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	RHA
LM4051AIM3-ADJ/NO.A	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 SMALL T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	RIA
LM4051AIM3-ADJ/NOPB	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 SMALL T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	RIA
LM4051AIM3X-1.2/NO.A	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	RHA
LM4051AIM3X-1.2/NOPB	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	RHA
LM4051AIM3X-ADJ/NO.A	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	RIA
LM4051AIM3X-ADJ/NOPB	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	RIA
LM4051BEM3-1.2/NO.A	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	RHB
LM4051BEM3-1.2/NOPB	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	RHB
LM4051BIM3-1.2/NO.A	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	RHB
LM4051BIM3-1.2/NOPB	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	RHB
LM4051BIM3-ADJ/NO.A	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	RIB
LM4051BIM3-ADJ/NO.B	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	RIB
LM4051BIM3-ADJ/NOPB	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	RIB
LM4051BIM3X-1.2/NO.A	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	RHB
LM4051BIM3X-1.2/NOPB	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	RHB
LM4051BIM3X-ADJ/NO.A	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	RIB
LM4051BIM3X-ADJ/NOPB	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	RIB
LM4051CIM3-1.2/NO.A	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 SMALL T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	RHC
LM4051CIM3-1.2/NOPB	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 SMALL T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	RHC
LM4051CIM3-ADJ/NO.A	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	RIC
LM4051CIM3-ADJ/NOPB	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	RIC
LM4051CIM3X-1.2/NO.A	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	RHC
LM4051CIM3X-1.2/NOPB	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	RHC
LM4051CIM3X-ADJ/NO.A	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	RIC
LM4051CIM3X-ADJ/NOPB	Active	Production	SOT-23 (DBZ) 3	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	RIC

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

TAPE AND REEL INFORMATION


*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
LM4051AIM3-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	180.0	8.4	3.2	2.85	1.3	4.0	8.0	Q3
LM4051AIM3-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	178.0	8.4	3.3	2.9	1.22	4.0	8.0	Q3
LM4051AIM3-ADJ/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	178.0	8.4	3.3	2.9	1.22	4.0	8.0	Q3
LM4051AIM3X-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	180.0	8.4	3.2	2.85	1.3	4.0	8.0	Q3
LM4051AIM3X-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	178.0	8.4	3.3	2.9	1.22	4.0	8.0	Q3
LM4051AIM3X-ADJ/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	178.0	8.4	3.3	2.9	1.22	4.0	8.0	Q3
LM4051BEM3-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	178.0	8.4	3.3	2.9	1.22	4.0	8.0	Q3
LM4051BEM3-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	180.0	8.4	3.2	2.85	1.3	4.0	8.0	Q3
LM4051BIM3-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	180.0	8.4	3.2	2.85	1.3	4.0	8.0	Q3
LM4051BIM3-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	178.0	8.4	3.3	2.9	1.22	4.0	8.0	Q3
LM4051BIM3-ADJ/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	178.0	8.4	3.3	2.9	1.22	4.0	8.0	Q3
LM4051BIM3X-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	180.0	8.4	3.2	2.85	1.3	4.0	8.0	Q3
LM4051BIM3X-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	178.0	8.4	3.3	2.9	1.22	4.0	8.0	Q3
LM4051BIM3X-ADJ/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	178.0	8.4	3.3	2.9	1.22	4.0	8.0	Q3
LM4051CIM3-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	178.0	8.4	3.3	2.9	1.22	4.0	8.0	Q3

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
LM4051CIM3-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	180.0	8.4	3.2	2.85	1.3	4.0	8.0	Q3
LM4051CIM3-ADJ/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	178.0	8.4	3.3	2.9	1.22	4.0	8.0	Q3
LM4051CIM3X-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	180.0	8.4	3.2	2.85	1.3	4.0	8.0	Q3
LM4051CIM3X-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	178.0	8.4	3.3	2.9	1.22	4.0	8.0	Q3
LM4051CIM3X-ADJ/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	178.0	8.4	3.3	2.9	1.22	4.0	8.0	Q3

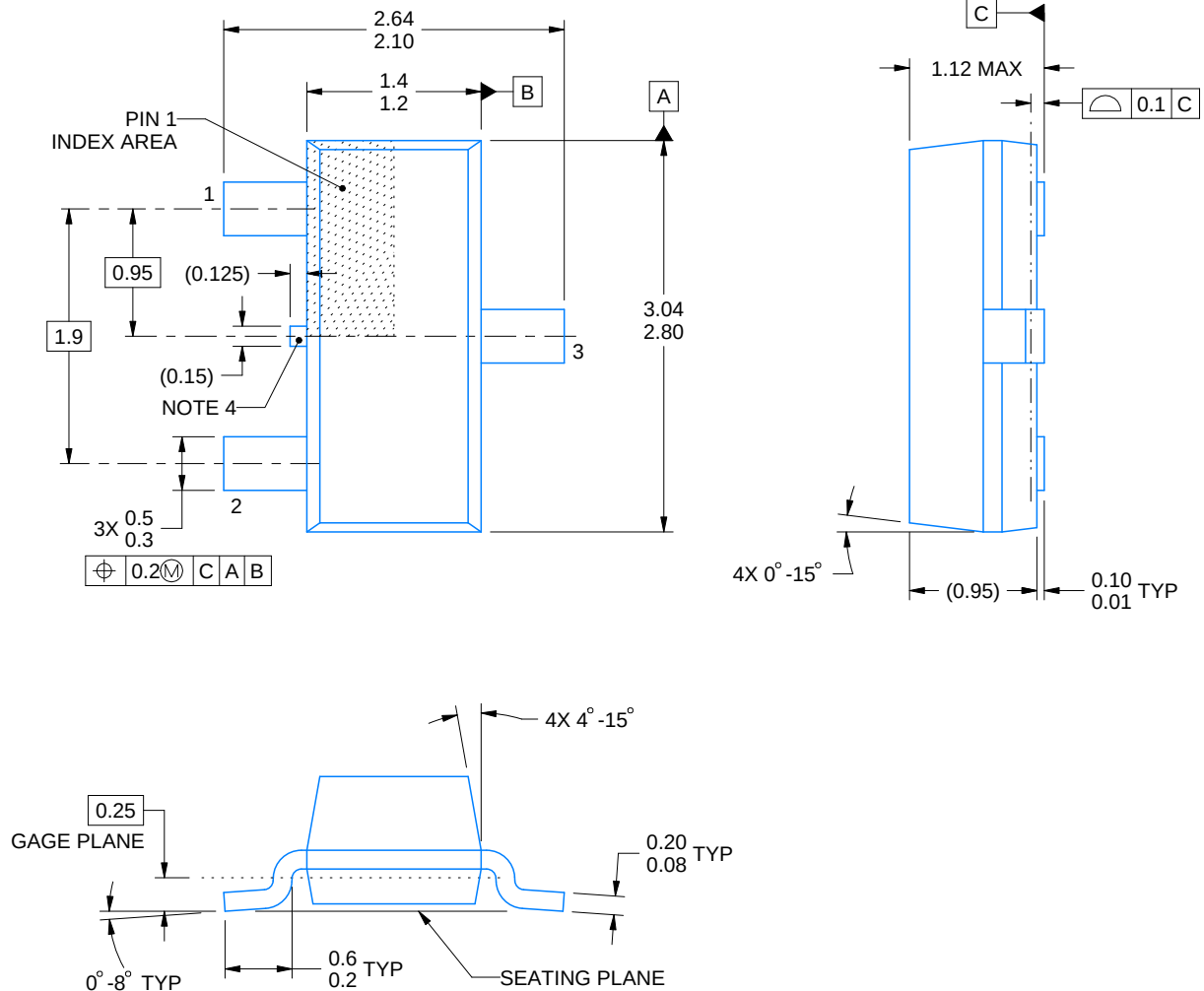
TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
LM4051AIM3-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	210.0	185.0	35.0
LM4051AIM3-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	208.0	191.0	35.0
LM4051AIM3-ADJ/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	208.0	191.0	35.0
LM4051AIM3X-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	210.0	185.0	35.0
LM4051AIM3X-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	208.0	191.0	35.0
LM4051AIM3X-ADJ/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	208.0	191.0	35.0
LM4051BEM3-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	208.0	191.0	35.0
LM4051BEM3-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	210.0	185.0	35.0
LM4051BIM3-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	210.0	185.0	35.0
LM4051BIM3-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	208.0	191.0	35.0
LM4051BIM3-ADJ/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	208.0	191.0	35.0
LM4051BIM3X-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	210.0	185.0	35.0
LM4051BIM3X-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	208.0	191.0	35.0
LM4051BIM3X-ADJ/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	208.0	191.0	35.0
LM4051CIM3-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	208.0	191.0	35.0
LM4051CIM3-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	210.0	185.0	35.0
LM4051CIM3-ADJ/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	208.0	191.0	35.0
LM4051CIM3X-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	210.0	185.0	35.0

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
LM4051CIM3X-1.2/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	208.0	191.0	35.0
LM4051CIM3X-ADJ/NOPB	SOT-23	DBZ	3	3000	208.0	191.0	35.0



4214838/F 08/2024

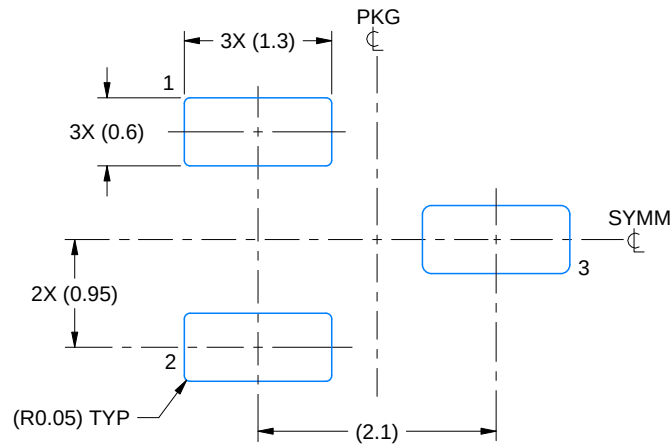
NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Reference JEDEC registration TO-236, except minimum foot length.
4. Support pin may differ or may not be present.
5. Body dimensions do not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.25mm per side

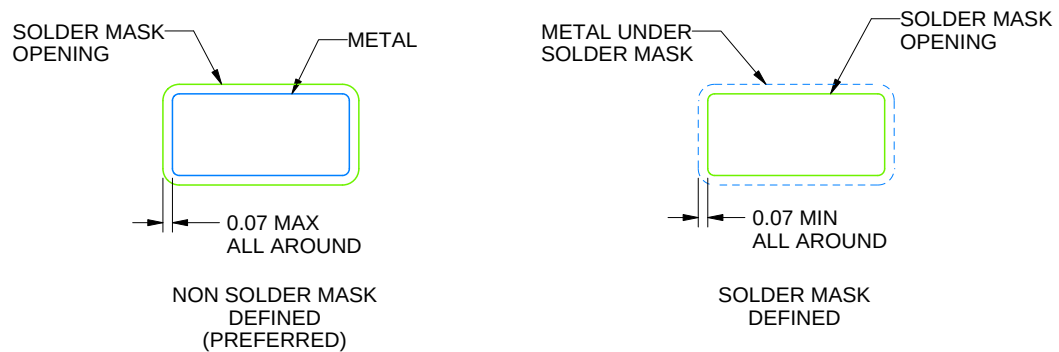
DBZ0003A

SOT-23 - 1.12 mm max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:15X



SOLDER MASK DETAILS

4214838/F 08/2024

NOTES: (continued)

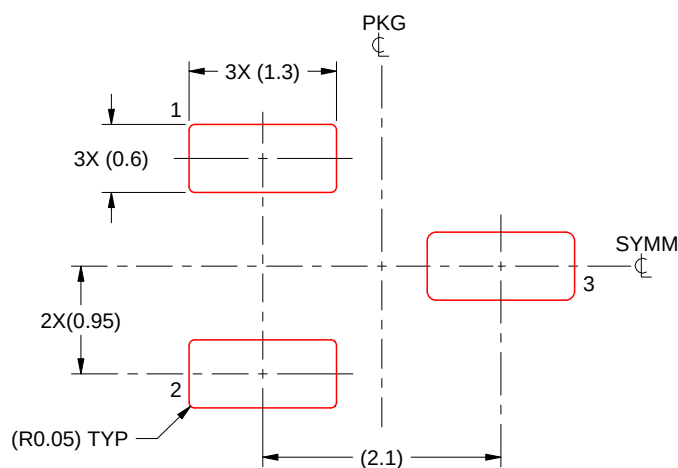
5. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
6. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DBZ0003A

SOT-23 - 1.12 mm max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 THICK STENCIL
SCALE:15X

4214838/F 08/2024

NOTES: (continued)

7. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
8. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
版权所有 © 2025，德州仪器 (TI) 公司